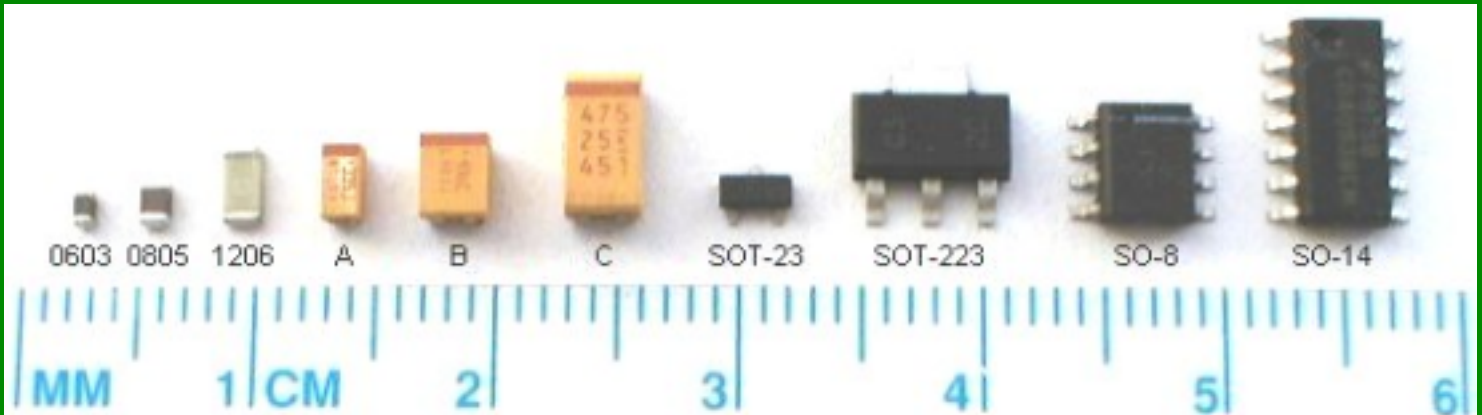


COMPONENTES SMD

La **tecnología de montaje superficial**, más conocida por sus siglas en inglés **SMT** (*Surface Mount Technology*) es el método de construcción de dispositivos electrónicos más utilizado actualmente. Se usa tanto para componentes activos como pasivos, y se basa en el montaje de los mismos (**SMC**, en inglés *Surface Mount Component*) sobre la superficie del circuito impreso. Tanto los equipos así construidos como los componentes de montaje superficial pueden ser llamados **dispositivos de montaje superficial**, o por sus siglas en inglés, **SMD** (*Surface Mount Device*).



Tenemos disponibilidad de componentes:

0805	SOIC	CQFP
1206	TSOP	QFN
1806	SSOP	PGA
SOT	TSSOP	LFBGA
DPAK (TO-252)	PLCC	
D2PAK (TO-263)	QFP	
D3PAK (TO-268)	LQFP	

Y las herramientas para trabajarlos, les esperamos.

